

2011-2015年中国芯片设计 行业市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国芯片设计行业市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qtIT1103/N4198478BJ.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2011-03-29

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国芯片设计行业市场分析与投资前景研究报告》共十一章。首先介绍了中国芯片设计行业的概念，接着分析了中国芯片设计行业发展环境，然后对中国芯片设计行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国芯片设计行业面临的机遇及发展前景。您若想对中国芯片设计行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

第一章 2010-2011年全球芯片设计行业运行状况探析

第一节 2010-2011年全球芯片设计行业基本特点

一、市场繁荣带动产业加速发展

二、企业重组呈现强强联合趋势

第二节 2010-2011年全球芯片设计行业结构分析

一、全球芯片设计行业产业规模

二、全球芯片设计行业产业结构

第三节 全球主要国家和地区发展分析

一、美国芯片设计行业发展分析

二、日本芯片设计行业发展分析

三、台湾芯片设计行业发展分析

四、印度芯片设计行业发展分析

第四节 2011-2015年全球芯片设计业趋势探析

第二章 2010-2011年世界典型芯片设计企业运行分析

第一节 高通 (QUALCOMM)

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第二节 博通 (BROADCOM)

一、企业概况

二、2010-2011年经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第三节 NVIDIA

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第四节 新帝 (SANDISK)

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第五节 AMD

一、企业概况

二、经营动态分析

三、企业竞争力分析

四、未来发展战略分析

第三章 2010-2011年中国芯片设计行业运行环境解析

第一节 国内宏观经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、2011年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2010-2011年中国芯片设计行业政策法规环境分析

一、国货复进口政策

二、政府优先发展IC设计业政策

三、各地IC设计产业优惠政策

四、数字电视战略推进表

五、外汇管理体制的缺陷

第三节 2010-2011年中国芯片设计行业技术发展环境分析

一、芯片工艺流程

- 二、低功率芯片技术可能影响整个芯片设计流程
- 三、我国技术创新与知识产权
- 四、我国芯片设计技术最新进展

第四章 2010-2011年我国芯片设计行业运行新形势透析

第一节 2010-2011年中国芯片设计行业运行总况

- 一、行业规模不断扩大
- 二、行业质量稳步提高
- 三、产品结构极大丰富
- 四、原材料与生产设备配套问题

第二节 2010-2011年中国芯片设计运行动态分析

- 一、产业持续快速发展，但增速呈逐年放缓趋势
- 二、中国自主标准为国内设计企业带来发展机遇
- 三、模拟IC和电源管理芯片成为国内IC设计热门产品

第三节 2010-2011年中国芯片设计行业经济运行分析

- 一、2008-2010-2011年行业经济指标运行
- 二、芯片设计业进出口贸易现状
- 三、行业盈利能力与成长性分析

第四节 2010-2011年中国芯片设计行业发展中存在的问题

- 一、企业规模问题分析
- 二、产业链问题分析
- 三、资金问题分析
- 四、人才问题分析
- 五、发展的建议与措施

第五章 2010-2011年中国芯片设计市场运行动态分析

第一节 2010-2011年中国芯片设计市场发展分析

- 一、中国芯片设计市场消费规模分析
- 二、主要行业对芯片的需求统计分析

第二节 2010-2011年中国芯片制造市场生产状况分析

- 一、芯片的产量分析
- 二、芯片的产能分析

三、产品生产结构分析

第三节 2010-2011年中国芯片设计产业发展地区比较

一、长三角地区

二、珠三角地区

三、环渤海地区

第六章 2010-2011年中国芯片设计产品细分市场运行态势分析

第一节 2010-2011年中国芯片细分市场发展趋势分析

一、生物芯片

二、通信芯片

三、显示芯片

四、数字电视芯片

五、标签芯片

第二节 电子芯片市场

一、电子芯片市场结构

二、电子芯片市场特点

三、电子芯片市场规模

四、2011-2015年电子芯片市场预测

第三节 通讯芯片市场

一、通讯芯片市场结构

二、通讯芯片市场特点

三、通讯芯片市场规模

第四节 汽车芯片市场

一、汽车芯片市场结构

二、汽车芯片市场特点

三、汽车芯片市场规模

四、2011-2015年汽车芯片市场预测

第五节 手机芯片市场

一、手机芯片市场结构

二、手机芯片市场特点

三、手机芯片市场规模

四、2011-2015年手机芯片市场预测

第六节 电视芯片市场

一、电视芯片市场结构

二、电视芯片市场特点

三、电视芯片市场规模

四、2011-2015年电视芯片市场预测

第七章 2010-2011年中国芯片设计业竞争产业竞争态势分析

第一节 2010-2011年中国芯片设计业竞争格局分析

一、国际芯片设计行业的竞争状况

二、我国芯片设计业的国际竞争力

三、外资企业进入国内市场的影响

四、IC设计企业面临的挑战分析

第二节 2010-2011年中国我国芯片设计业的竞争现状综述

一、我国芯片设计企业间竞争状况

二、潜在进入者的竞争威胁

三、供应商与客户议价能力

第三节 2010-2011年中国芯片设计业集中度分析

一、区域集中度分析

二、市场集中度分析

第四节 2010-2011年中国芯片设计业提升竞争力策略分析

第八章 2010-2011年中国芯片设计行业内优势企业财务分析

第一节 大唐微电子技术有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 大连路美芯片科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 上海华虹NEC电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 上海蓝光科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 福州瑞芯微电子有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 有研半导体材料股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 大连路美芯片科技有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业运营能力分析
- 六、企业成长能力分析

第九章 2010-2011年中国芯片设计相关产业运行分析

- 第一节 IC制造业
- 第二节 IC封装测试业
- 第三节 IC材料和设备行业
- 第四节 上游原材料

第十章 2011-2015年中国芯片设计行业前景预测与趋势分析

- 第一节 2011-2015年中国芯片业前景领域展望
 - 一、节能芯片前景展望
 - 二、电视芯片前景预测分析
 - 三、手机多媒体芯片市场前景研究
 - 四、TD芯片前景好转
- 第二节 2011-2015年中国芯片设计市场发展预测
 - 一、2010-2011年中国芯片设计市场规模预测
 - 二、细分市场规模预测
 - 三、产业结构预测
 - 四、销售模式：由提供芯片向提供整体解决方案转变

第十一章 2011-2015年中国芯片设计行业投资战略分析

- 第一节 2011-2015年中国芯片设计行业投资概况
 - 一、芯片设计行业投资特性
 - 二、芯片设计行业投资环境分析
- 第二节 2011-2015年中国芯片设计行业投资机会分析
 - 一、台湾放行四家芯片商投资大陆

二、半导体芯片产业或成投资热点

三、应用芯片研究前景广阔

四、生物芯片投资时刻到来

第三节 2011-2015年中国芯片设计行业投资风险预警

一、市场竞争风险

二、政策性风险

三、技术风险

四、进入退出风险

第四节 投资建议

图表目录：（部分）

图表：2007-2012全球UWB芯片市场规模

图表：2007-2015年印度芯片设计企业数量及增长趋势

图表：2006-2010年国内生产总值

图表：2006-2010年居民消费价格涨跌幅度

图表：2010年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2006-2010年年末国家外汇储备

图表：2006-2010年财政收入

图表：2006-2010年全社会固定资产投资

图表：2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2010年固定资产投资新增主要生产能力

图表：2010年房地产开发和销售主要指标完成情况

图表：1999-2009年我国集成电路芯片产量变动轨迹 单位：万片

图表：1999-2009年集成电路及芯片产量变动轨迹 单位：万片

图表：2009年中国手机芯片市场产品结构

图表：2009年中国手机芯片市场产品结构

图表：2011-2015年电子导体市场预测

图表：2010-2015我国通讯芯片市场规模及增长率

图表：2010-2015我国汽车芯片销售收入及增长率预测

图表：2011-2015年中国手机芯片市场规模及增长预测

图表：2009年中国液晶电视芯片市场应用结构

图表：2004-2009年中国液晶电视芯片市场销售额规模及增长

图表：2010-2011年中国集成电路制造业区域集中度情况

图表：2009年中国芯片市场集中度

图表：大唐微电子技术有限公司主要经济指标走势图

图表：大唐微电子技术有限公司经营收入走势图

图表：大唐微电子技术有限公司盈利指标走势图

图表：大唐微电子技术有限公司负债情况图

图表：大唐微电子技术有限公司负债指标走势图

图表：大唐微电子技术有限公司运营能力指标走势图

图表：大唐微电子技术有限公司成长能力指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司主要经济指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司经营收入走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司盈利指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司负债情况图

图表：大连路美芯片科技有限公司负债指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司运营能力指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司成长能力指标走势图

图表：上海华虹NEC电子有限公司主要经济指标走势图

图表：上海华虹NEC电子有限公司经营收入走势图

图表：上海华虹NEC电子有限公司盈利指标走势图

图表：上海华虹NEC电子有限公司负债情况图

图表：上海华虹NEC电子有限公司负债指标走势图

图表：上海华虹NEC电子有限公司运营能力指标走势图

图表：上海华虹NEC电子有限公司成长能力指标走势图

图表：上海蓝光科技有限公司主要经济指标走势图

图表：上海蓝光科技有限公司经营收入走势图

图表：上海蓝光科技有限公司盈利指标走势图

图表：上海蓝光科技有限公司负债情况图

图表：上海蓝光科技有限公司负债指标走势图

图表：上海蓝光科技有限公司运营能力指标走势图

图表：上海蓝光科技有限公司成长能力指标走势图

图表：福州瑞芯微电子有限公司主要经济指标走势图

图表：福州瑞芯微电子有限公司经营收入走势图

图表：福州瑞芯微电子有限公司盈利指标走势图

图表：福州瑞芯微电子有限公司负债情况图

图表：福州瑞芯微电子有限公司负债指标走势图

图表：福州瑞芯微电子有限公司运营能力指标走势图

图表：福州瑞芯微电子有限公司成长能力指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司主要经济指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司经营收入走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司盈利指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司负债情况图

图表：有研半导体材料股份有限公司负债指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司运营能力指标走势图

图表：有研半导体材料股份有限公司成长能力指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司主要经济指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司经营收入走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司盈利指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司负债情况图

图表：大连路美芯片科技有限公司负债指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司运营能力指标走势图

图表：大连路美芯片科技有限公司成长能力指标走势图

图表：2005-2009年中国集成电路市场销售额规模及增长

图表：2010-2011年中国集成电路市场应用结构预测

图表：2004-2009年中国集成电路产业销售收入规模及增长

图表：2009年中国集成电路产业各产业链销售收入及增长

图表：LED产业链投资规模估算

图表：略……

更多图表见报告正文

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtIT1103/N4198478BJ.html>